

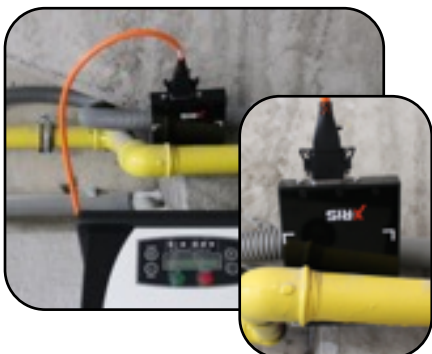
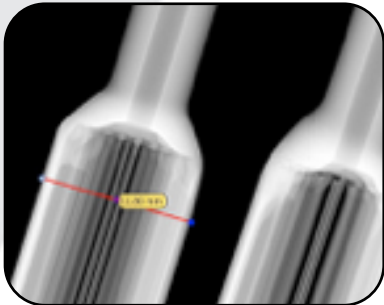
便携式高分辨率

— 无损检测DR探测器

应用领域

随时随地获得高分辨率 (48 or 96 μm) X射线数字图像

- ▶ 铝, 钛, 钢铁, 复合材料 ... 薄板和管道的无损检测
- ▶ 复合材料中团块结构, 分层, 褶皱等缺陷的无损检测
- ▶ 蜂窝结构, 丝, 孔等复杂结构分析和无损检测
- ▶ 各类金属材质的焊接结构缺陷
- ▶ 树脂, 注塑工艺中的缺陷, ...
- ▶ 有机和无机材料的粘接缺陷的无损检测



主要特点

数字化

- ▶ 无需工业胶片, 化学试剂和暗室
- ▶ 易于存档和自动生成报告 (TIFF 和 JPG 格式)
- ▶ 实时数字化成像, 更能录制检测视频, 快速高效的进行缺陷分析

图像质量

- ▶ 48 μm 或96 μm 像素尺寸 \Rightarrow 符合 ISO 17636-2 class B 工件厚度1.5 到12 mm Fe
- ▶ 14 bit
- ▶ 快速自动的图像叠加降噪, 实现高信噪比(SNR)

简单快速的部署

- ▶ 分体式 (成像板和控制器分离) 探测器设计: 探测器小型化 方便在狭小空间内拍摄X射线数字图像
- ▶ 成像区域紧邻探测器边缘 (仅3.5mm)
- ▶ 1分钟内即可完成连接和部署
- ▶ 控制器GUC-HR 通用所有DeReO HR 探测器(GUC-HR兼容48 μm 和 96 μm 探测器)

便携性强大

- ▶ 探测器轻量化设计
- ▶ 1.5 kg 的GUC-HR 内置电池提供8小时工作时间, 真正轻量便携
- ▶ 可以边工作边为内置电池充电
- ▶ 可以将 DeReO HR 探测器固定在标准的照相机三脚架上, 方便部署
- ▶ 使用标准的以太网通讯, 也可以无线连接 (可选)
- ▶ 可以与便携式恒电压小焦点 GemX 射线机无线连接 (option)

坚固耐用

- ▶ 符合 IP65
- ▶ 适合恶劣环境使用的坚固连接件和外壳

直观易用的数字化工具

- ▶ 录像模式: 实时调节kV和mA参数, 立即得到最优化的高质量图像
- ▶ 照片模式: 图像自动叠加处理得到高信噪比SNR的数字图像
- ▶ 实时图像处理滤镜 (局部和整体灰度优化, 边缘增强, 3d浮雕...)
- ▶ 图像处理工具高度智能化和集成化, 简单易用

兼容多种X射线源

- ▶ DeReO HR 和 GemX-160同步工作, 也可以与其他恒电压X射线源配套工作

DeReO HR 平板探测器

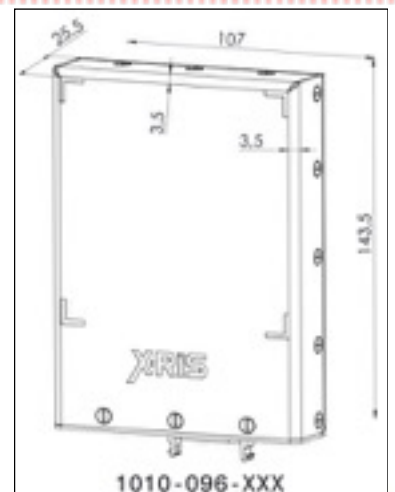
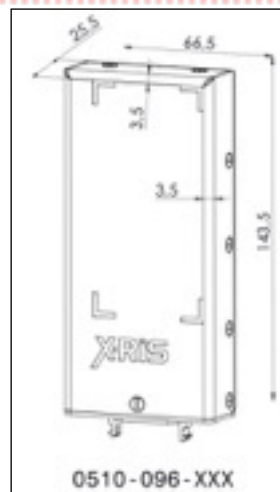
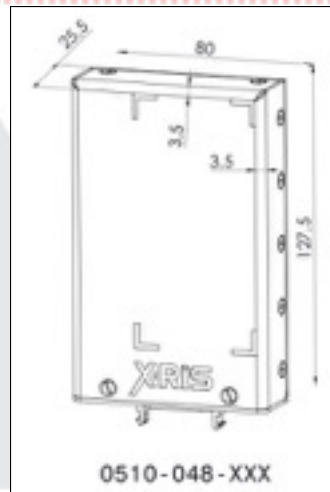
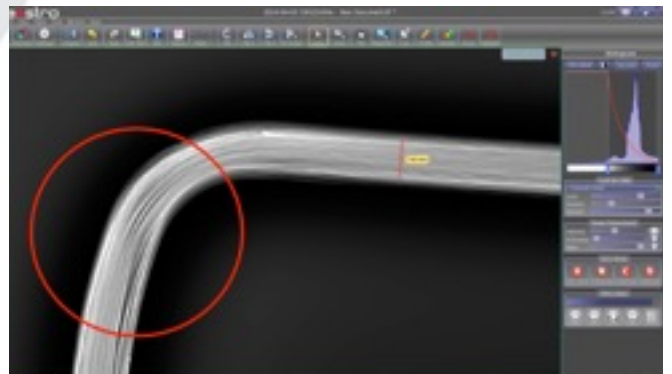
- 分体式设计
- 通用型控制器GUC-HR重量仅1.5kg (内置电池模块和通讯模块)兼容HR 系列探测器, 内置电池可以提供8小时供电
- CMOS 探测器
- GadOx 闪烁体可以选择不同厚度(60, 105, 140, 208 μm , ...)

型号	成像面积	像素尺寸	灰度等级	# 成像单元	外形尺寸 (mm)	重量 (kg)
0510-048-XXX*	05 x 10 cm	48 μm	14 bit	4	127,5 x 80 x 25,5	0.610
0510-096-XXX*	05 x 10 cm	96 μm	14 bit	1	143,5 x 66,5 x 25,5	0.550
1010-096-XXX*	10 x 10 cm	96 μm	14 bit	2	143,5 x 107 x 25,5	0.900

* XXX 代表闪烁体厚度, 闪烁体厚度影响图像质量和探测器灵敏度。
 *GadOx 闪烁体可以选择不同厚度(60, 105, 140, 208 μm , ...)

MAESTRO NDT软件

- 符合NDT标准
- 功能高度智能化集成, 简单易用
- 实时X射线成像
- 实时调节GemX的kV, mA和曝光时间等参数
- 图像移动, 放大, 缩小, 旋转, 水平和垂直翻转, 镜像, 图像剪裁...
- 图像直方图LUT (look-up-table)
- 射线图像正片和负片转换
- 实时灰度调节滤镜
- 实时边缘增强
- 图像3D浮雕显示
- NDT无损检测专用图像处理工具 (降噪, 频率过滤器 ...)
- 测量工具/ 灰度曲线图
- 图像文件可添加各种标准和注释
- 原始图像和经过处理的图像都会被保存
- 像素图
- 汉化工作界面



www.xriss.eu